

中期計画
第3次「tokチャレンジ21」
2007年3月期～2009年3月期

2006年5月18日

目次

- 1. 第2次「tokチャレンジ21」総括 . . . p.2
- 2. 第3次「tokチャレンジ21」
 - 2-1. 中期計画概要 . . . p. 6
 - 2-2. 事業別活動方針 . . . p.15
- 3. 新たな成長ステージに向けて . . . p.23
- 4. 要約 . . . p.24

**第2次 「tokチャレンジ21」
総括**

第2次中期計画の概要とその成果

微細加工技術の多角的展開

- 「垂直的展開」の加速・追及
- 「水平的展開」の充実・拡大
- コラボレーションの推進
- 研究開発の強化

過去最高の利益をキャッチアップする
プロセスの構築

海外展開の強化

- 台湾子会社の生産能力増強
- 韓国販売子会社の設立
- 中国合弁会社の設立
- 欧州販売子会社の整備

経営基盤の強化

- ERPの導入
- 危機管理体制の強化
- コンプライアンス体制の整備

微細加工技術の多角的展開

「垂直的展開」の加速・追及

液浸材料の開発、シュリンク材料の提案
ナノプロセス開発部の設置

「水平的展開」の充実・拡大

ブラックレジストの伸長、実装/パッケージ材料の展開
開発企画室、営業開発室の設置による新規事業の模索

コラボレーションの推進

ウェハサポートシステムの共同開発（三洋電機）
ナノコーティング材料の共同開発（理化学研究所）

研究開発の強化

新研究開発棟の建設

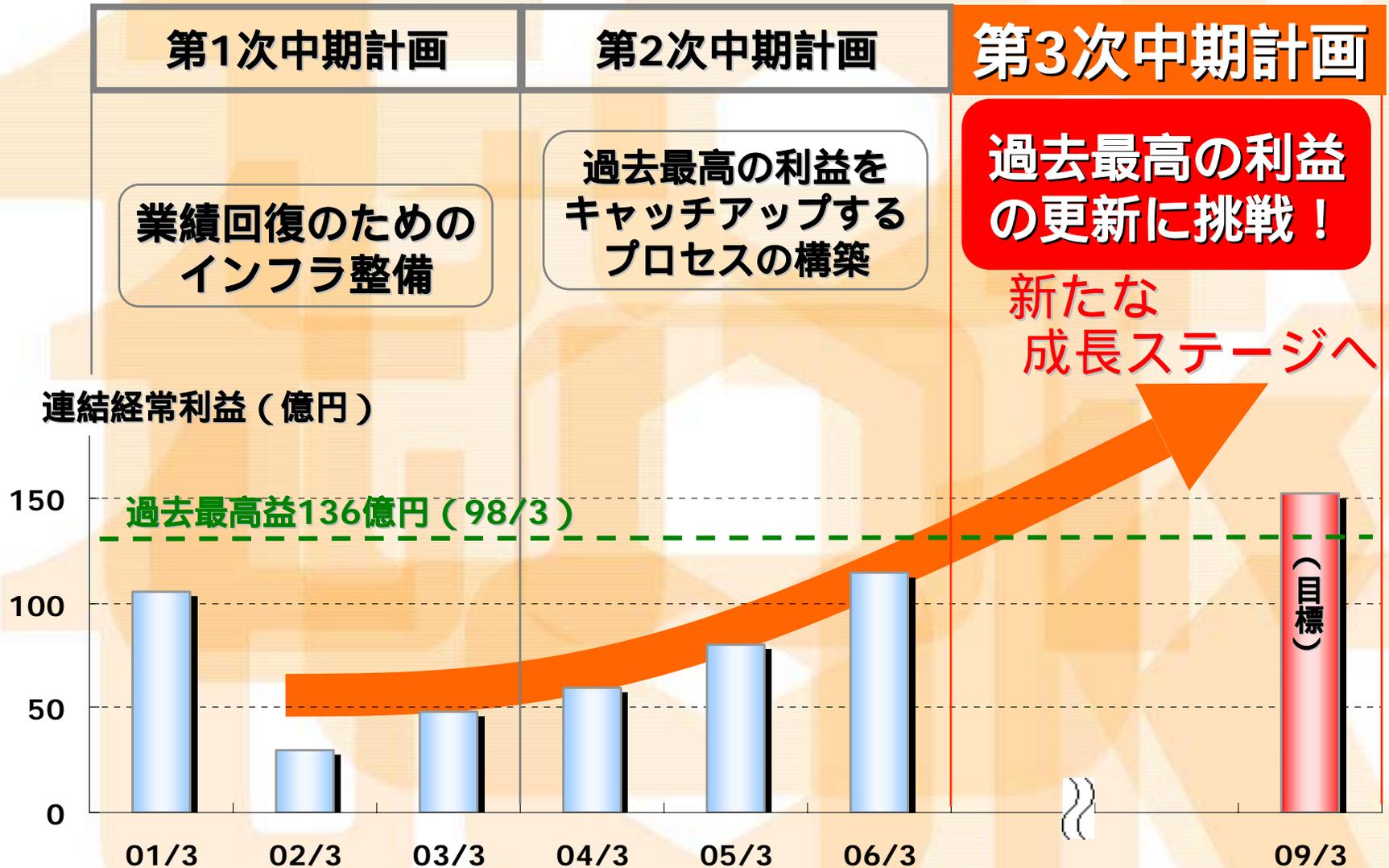
経営成績（連結）

（百万円）

	2003/3 実績	2006/3 中計目標	2006/3 実績	対目標値 (%)
売上高	72,286	93,800	98,514	105.0
営業利益	4,563	9,100	10,544	115.8
経常利益	4,838	9,200	11,156	121.2
当期純利益	1,924	5,000	6,656	133.1
経常利益率	6.7%	9.8%	11.3%	+1.5%
海外売上比率	49%	58%	59%	+1.0%

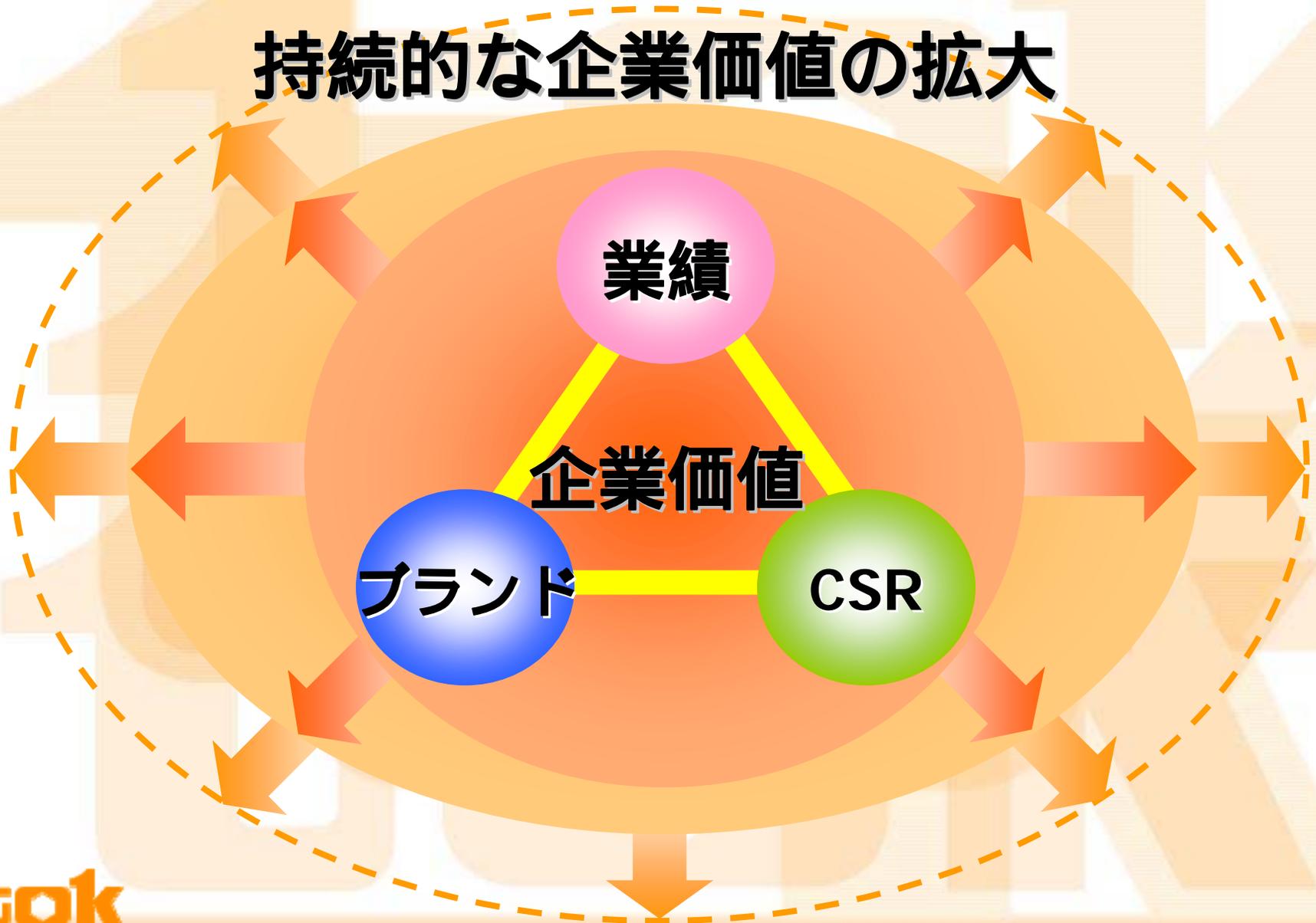
**第3次 「tokチャレンジ21」
中期計画概要**

第3次中期計画の位置づけ



第3次中期計画の基本的な考え方

持続的な企業価値の拡大



基本戦略

1. 微細加工技術の進化

成長事業領域への経営資源の集中
新事業領域の創出

2. グローバル市場でのTOKブランドの確立

世界No.1半導体フォトレジスト事業を生かした既存事業への展開
顧客満足の徹底
海外拠点の充実

3. 経営体質の強化

CSRの推進
ITシステムの有効活用

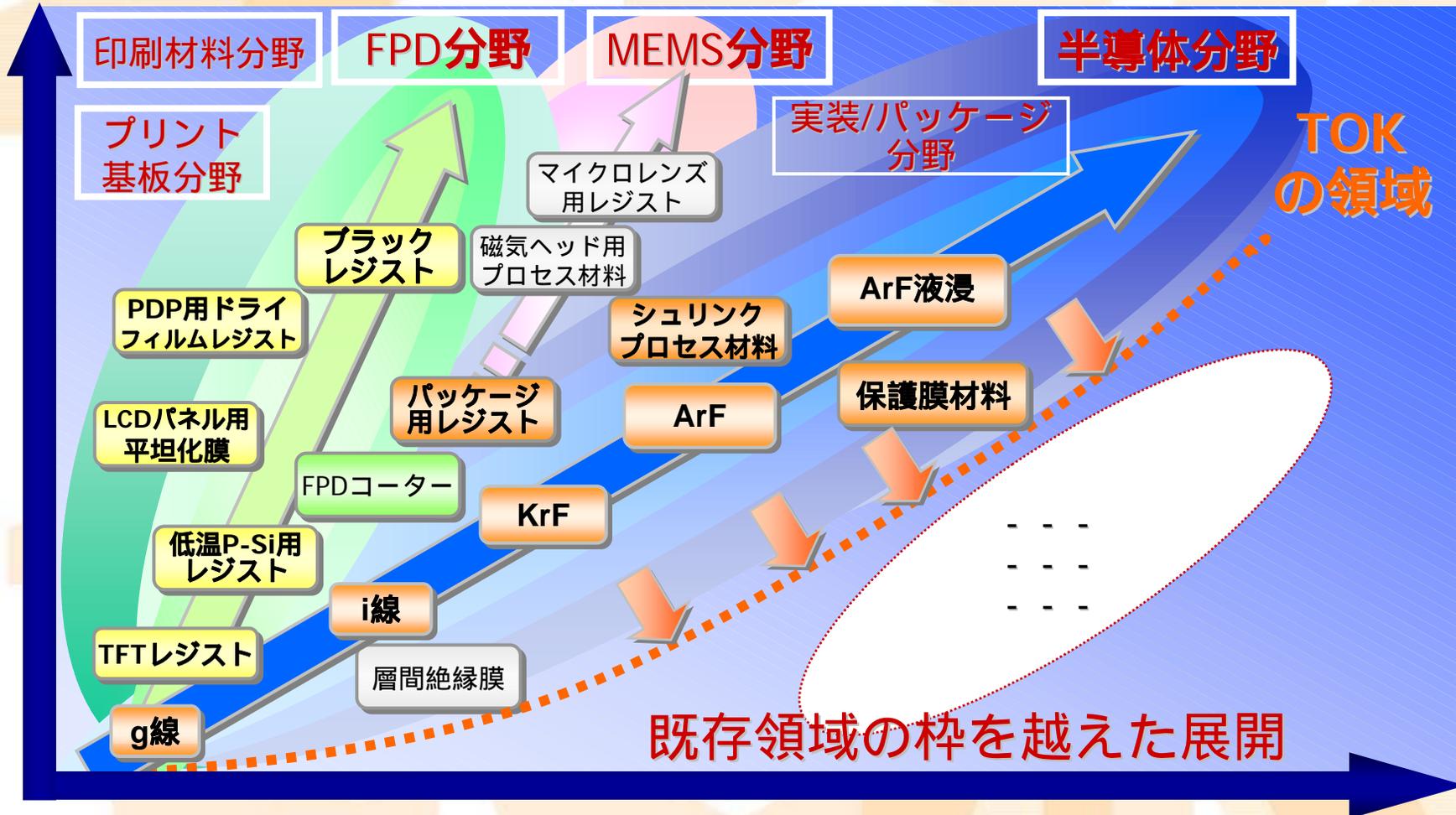
内部統制システムの構築

4. 企業風土改革

現場力の向上

変化に柔軟に対応できる組織の実現

「微細加工技術の進化」



研究開発の強化

微細加工技術の「フラッグシップ」

半導体分野の最先端微細加工技術の開発力

「TOKブランド」「新規事業領域創出」

新研究開発棟（2006年度運用開始）

ArF液浸スキャナーの導入
300mmウェハ対応の最新鋭研究開発機器
スーパークリーンルームの設置
（清浄度 ISOクラス 3.5 以下）



フォトレジスト、カバーコート等の製品開発、
液浸、その他の微細加工プロセス開発をも加速

【投資額】

第1期：約65億円

第2期以降：約89億円（第1期分を含む）

研究開発拠点を1極集中化

連結業績数值目標

(百万円、%)

	2006/3 実績	2009/3		
		中計目標	増減	増減率
売上高	98,514	120,000	+21,486	+21.8
(材料)	(80,338)	(102,000)	(+21,662)	(+26.9)
(装置)	(18,175)	(18,000)	(-175)	(-0.9)
営業利益	10,544	15,000	+4,456	+42.2
(材料)	(12,665)	(18,400)	(+5,735)	(+45.2)
(装置)	(2,343)	(1,100)	(-1,243)	(-53.0)
経常利益	11,156	15,300	+4,144	+37.1
当期純利益	6,656	9,100	+2,444	+36.7
経常利益率	11.3%	12.8%	+1.5%	-

設備投資等の計画（連結）

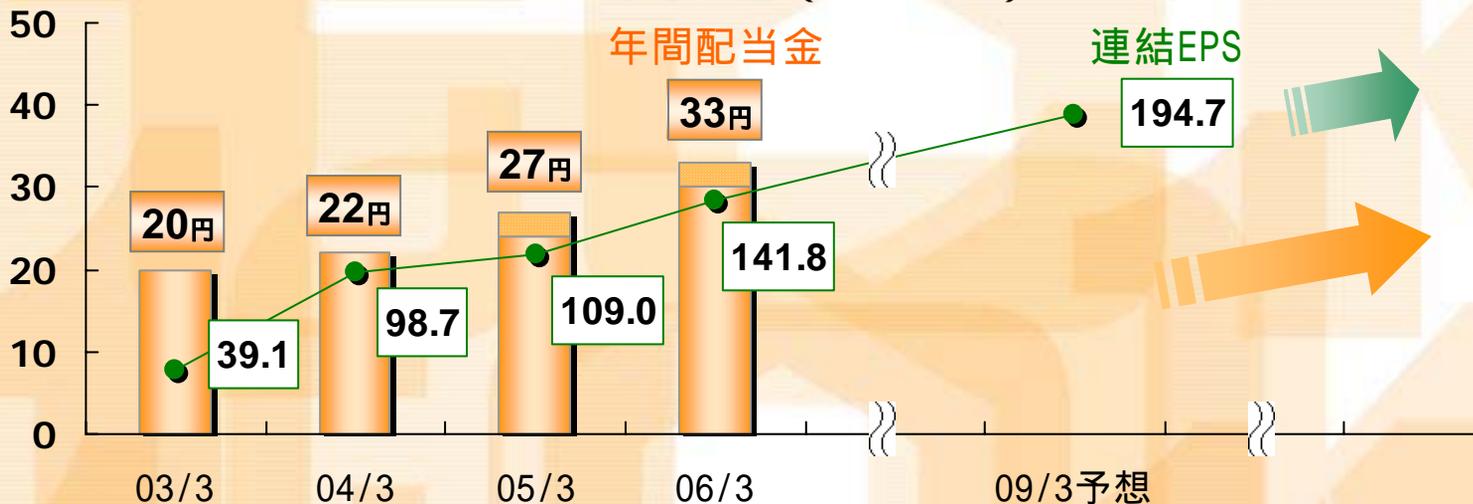
（百万円）

	第2次中計 04/3～06/3	第3次中計	
		07/3～09/3	増減
キャッシュフロー	33,402	44,100	+10,698
当期純利益	16,495	24,300	+7,805
減価償却費	16,907	19,800	+2,893
設備投資	14,724	24,200	+9,476
フリーキャッシュフロー	18,678	19,900	+1,222
研究開発費	18,227	23,300	+5,073

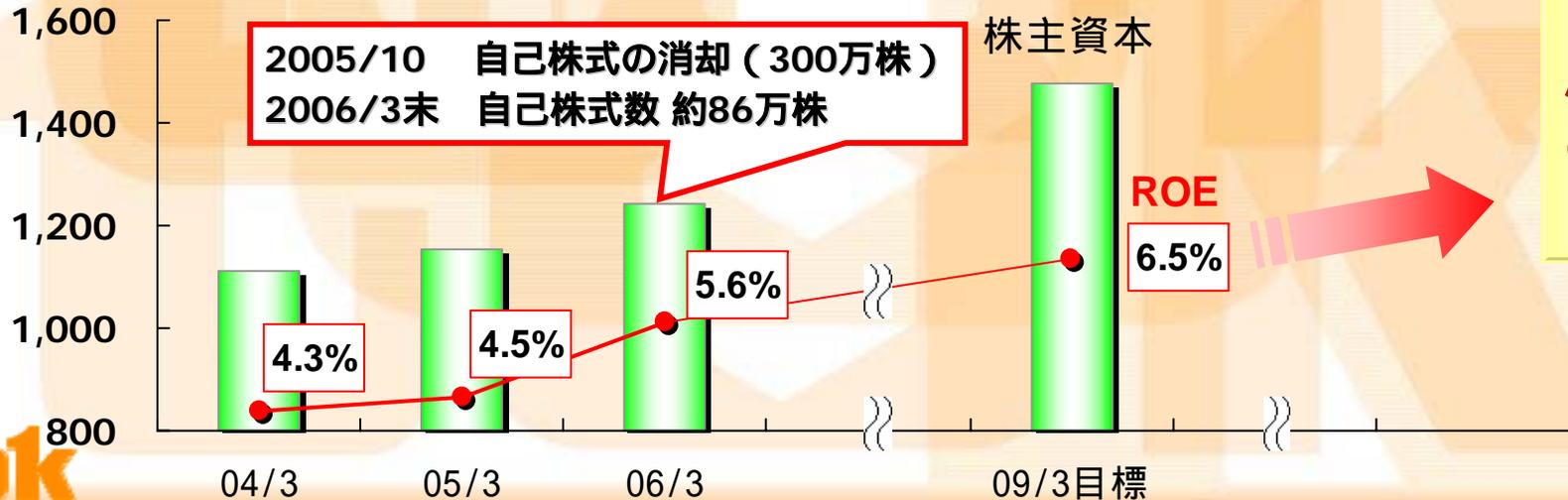
- （注）1. 上記キャッシュフローは、当期純利益と減価償却費を合計し算出しております。
 2. 上記フリーキャッシュフローは、キャッシュフローから設備投資額を控除し算出しております。

株主価値の向上について

配当金（円） 1株当たりの当期純利益（連結EPS）と年間配当金



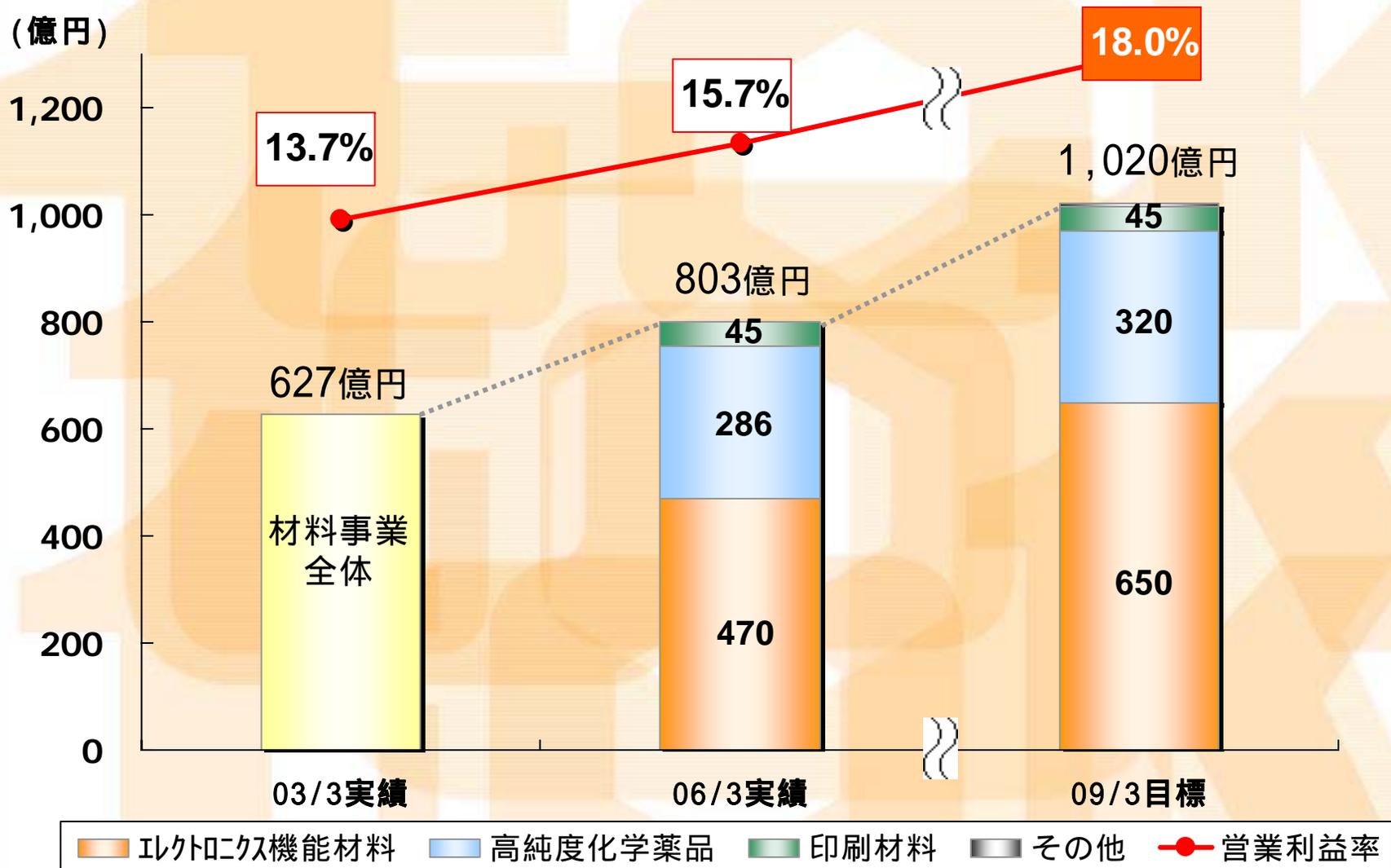
連結株主資本（億円） 連結ROEと連結株主資本



長期、
持続的な成長

第3次「tokチャレンジ21」 事業別活動方針

材料事業の数値目標（連結）



成長製品群の売上貢献

第3次中期計画の売上目標

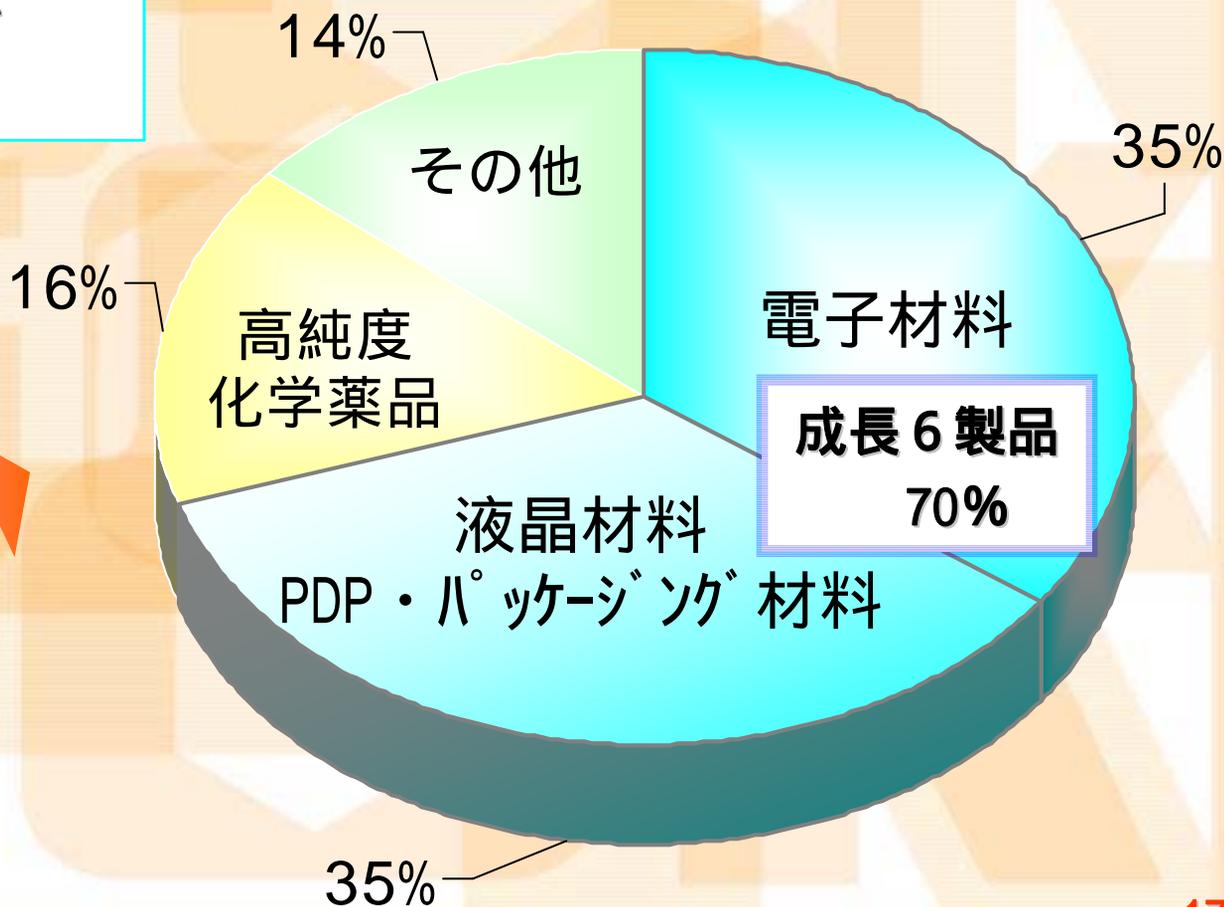
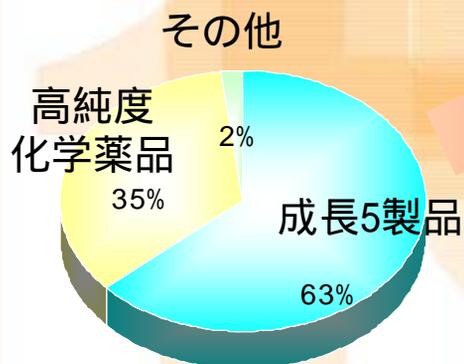
- 最終年度 09/3期 -
06/3期比 +216億円増加

成長6製品 = 成長5製品 + 1

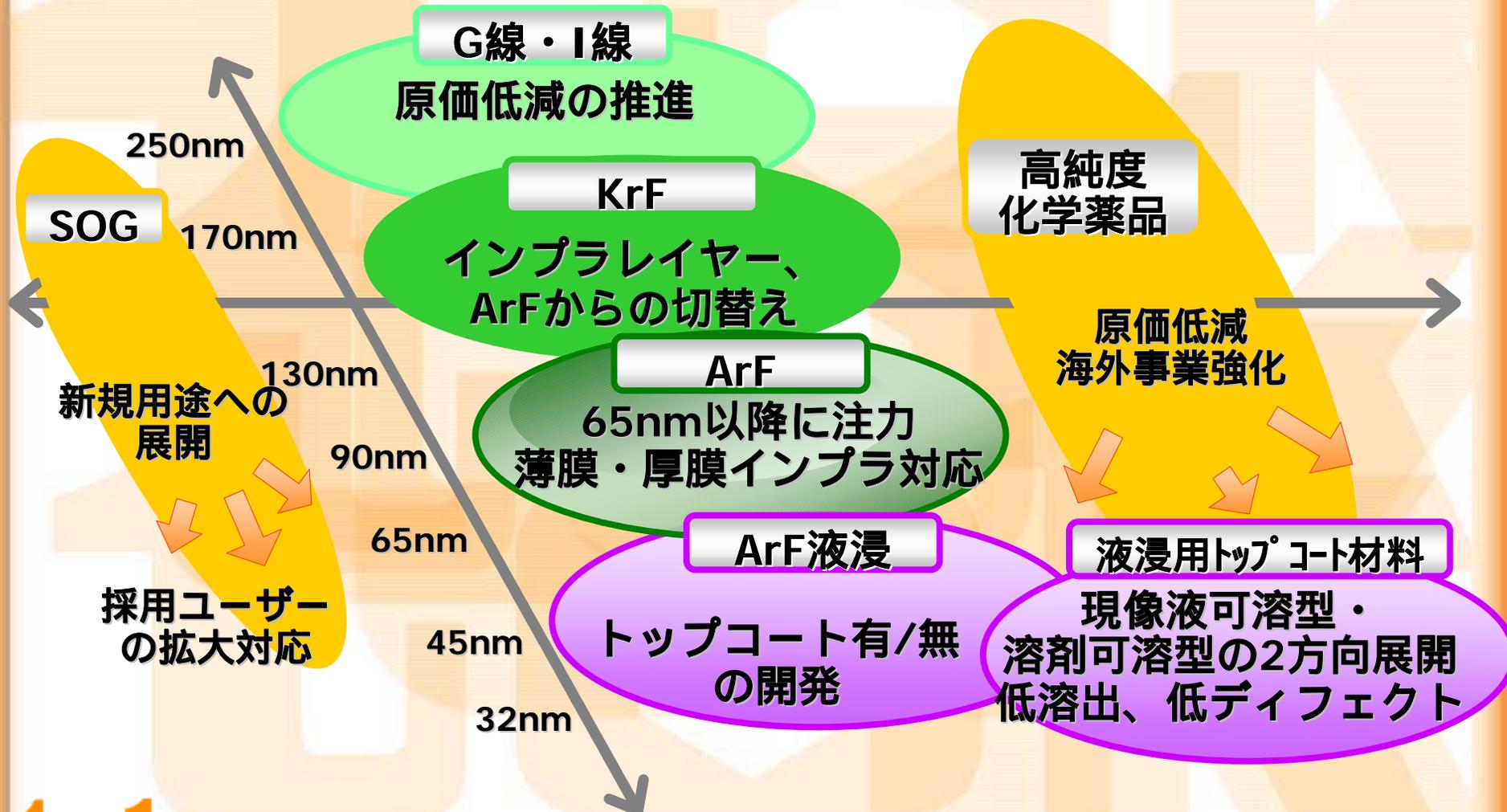
KrF、ArF、TFTレジスト、
CFレジスト、PDP材料
+
実装/パッケージ材料

第2次中期計画の売上実績

- 最終年度 06/3期 -
(03/3期比+176億円増加)



活動方針 : 電子材料事業



活動方針 : 液晶材料事業

TFTアレイ用レジスト

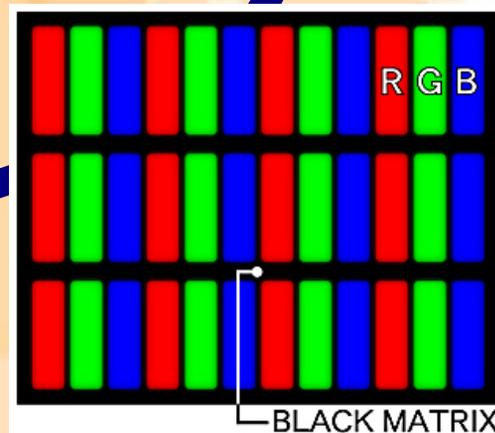
- ・コスト削減の継続
- ・アジア市場での拡販

高純度化学薬品

- ・コスト削減
- ・海外事業の強化

CF用レジスト (ブラックレジスト)

- ・第7・第8世代対応
- ・増産体制の構築
- ・原価低減



活動方針 : PDP・パッケージング材料事業

PDP材料

- ・ SB法（サンドブラスト）の優位性確立
- ・ 誘電体ペーストの拡販

回路基板材料

- ・ コスト削減
- ・ 高付加価値製品に絞った拡販

実装/パッケージ材料

- ・ 高シェア維持
- ・ 新規分野・用途の開拓
(LCDドライバー実装以外への展開)



活動方針 : 印刷化材事業

エラスロン

- 国内市場に注力
(ダンボール用途)
- インクジェットCTPシステムの拡販

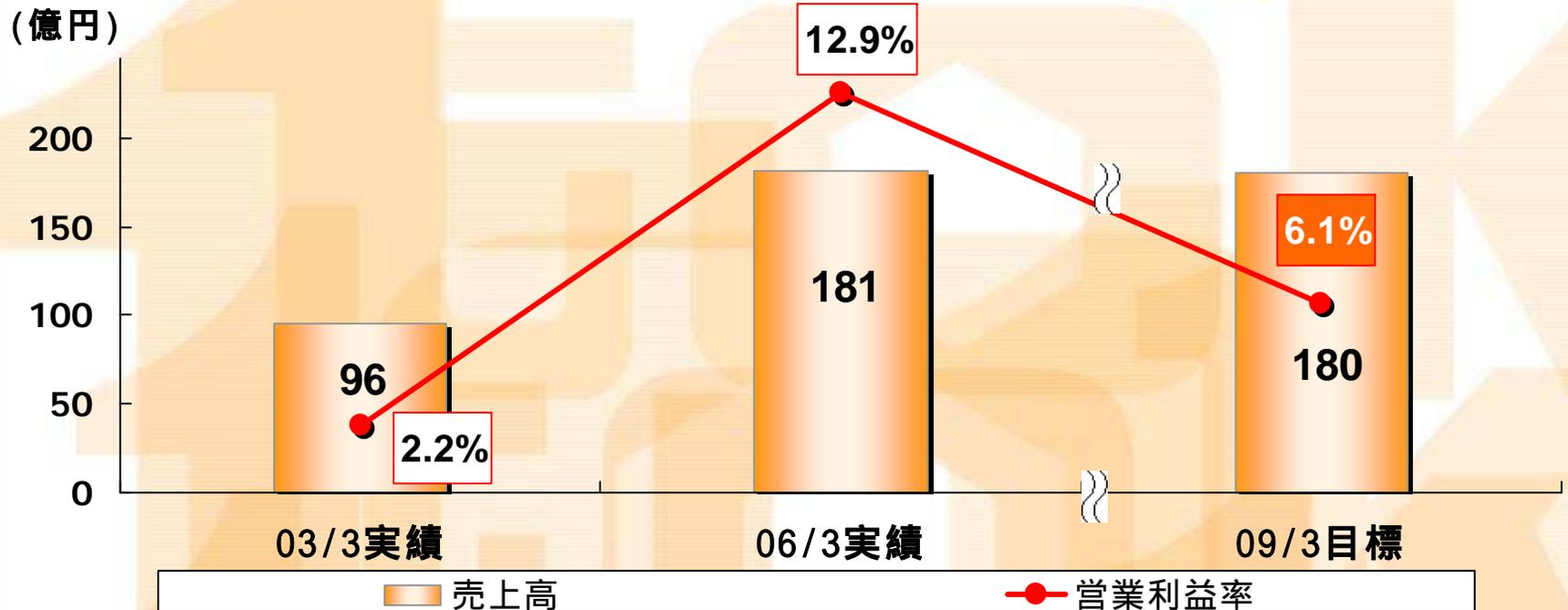
ミラクロン

- 国内シェア維持
(ドライオフタイプ)
- EU市場での販売強化
- 中国市場等での拡販

共通課題

- 原価管理の徹底強化
- 生産効率改善、作業工程の見直し
- 部材内製化の推進

装置事業の数値目標と活動方針



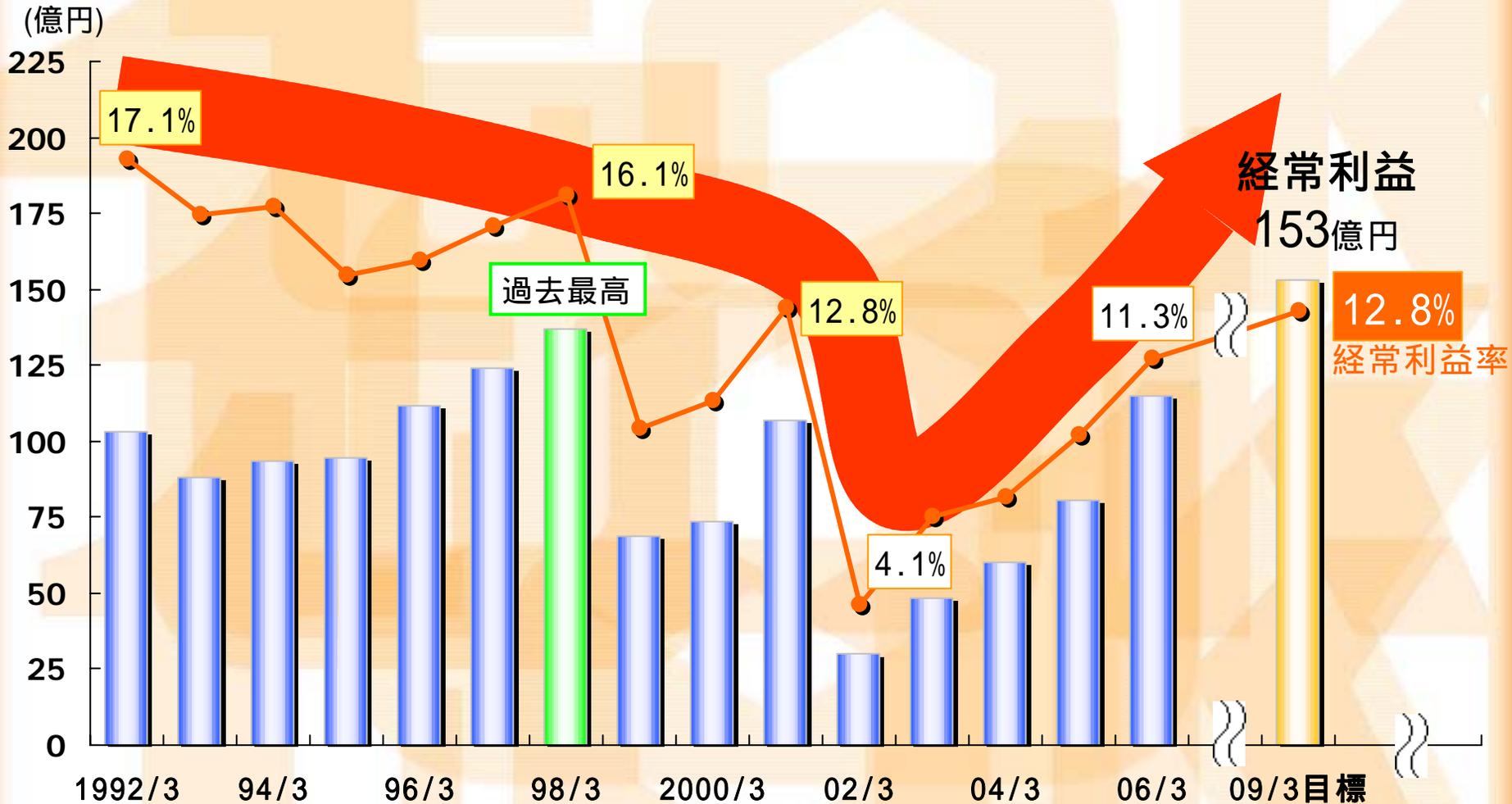
液晶CF用コーター

コストダウンの徹底による収益性の向上
第8世代対応装置の早期開発

M&E (Materials & Equipment) 戦略の推進

材料事業とのシナジー効果が期待できる“ポスト・コーター事業”の創出
ex.) ウェハサポート装置の開発 既存技術の新規用途への展開

新たな成長ステージに向けて



要約

経営ビジョン

- CSR（企業の社会的責任）意識の高い会社
- ファインケミカル分野の世界市場で、高いシェアを有し、利益率の高い製品を数多く有する会社
- 収益力が高く、財務内容の健全な会社
- ステークホルダーから高い信頼と満足を寄せられるブランド力のある会社

「継続的に利益の出せる良い会社」

- 企業価値の持続的拡大 過去最高益の更新が第一歩
- 微細加工技術の進化・TOKブランドの確立
- CSR意識の高い会社（株主/顧客/取引先/社員/社会 等）

<http://www.tok.co.jp/>

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。